

Pressemitteilung

Technische Universität Dresden

Birgit Berg

03.11.2003

<http://idw-online.de/de/news71478>

Forschungsprojekte
Bauwesen / Architektur
überregional

Feuchten Wänden den Kampf angesagt

BAUFACH 2003, Leipzig, 6. bis 9. November 2003, Gemeinschaftsstand FORSCHUNG FÜR DIE ZUKUNFT, Halle 4 - Baulive Wissenschaftler des Instituts für Bauklimatik informieren über Simulationsprogramme DELPHIN₄ und COND 2002

Feuchte Wände sind nicht nur unansehnlich, sie begünstigen auch das Wachstum von gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzen. Um diese Risiken zu vermeiden, ist die Auswahl der Materialien und Konstruktionen bei der Planung eines Bauvorhabens genau abzuwägen. Das Institut für Bauklimatik der Fakultät Architektur der TU Dresden stellt mit den Simulationsprogrammen DELPHIN₄ und COND 2002 gleich zwei Projekte auf der Baufachmesse vor, um hygrischen und thermischen Problemen beim Hausbau zu Leibe zu rücken.

Das kompakte COND 2002 ist ein Bemessungsprogramm, das in einem Schnelltest Wand und Decke auf Kondenswasserbelastung und mögliche Fehler in der Baukonstruktion überprüft. DELPHIN₄ dagegen ist die ausführlichere Variante der Simulationssoftware. Die Analyse des Feuchte-Wärme-Transports informiert über vorhandene Problembereiche, die Dauerhaftigkeit eines Baumaterials und dessen Schimmelbeständigkeit. Durch die sehr genaue Simulation von Feuchte- und Wärmeleitprozessen kann der Bauplaner auf zeit- und kostenintensive Praxistests verzichten und vermeidet Bauschäden. COND ist vor allem für mittelständische Betriebe, Baustoffunternehmen und Gutachter geeignet. DELPHIN₄ richtet sich in erster Linie an erfahrene bauphysikalische Ingenieure und Wissenschaftler. Im institutseigenem Labor werden Materialkennwerte für bauklimatische Bemessungen und Simulationen ermittelt. Auf dieser Grundlage lassen sich in Zusammenarbeit mit der Bauindustrie neue Baustoffe entwickeln und vorhandene Materialien ihren Einsatzgebieten entsprechend optimieren.

URL zur Pressemitteilung: Weitere Informationen für Journalisten: Ulrich Ruisinger, Tel. 0351 463-36186, E-Mail: ruisinger@ibk.arch.tu-dresden.de